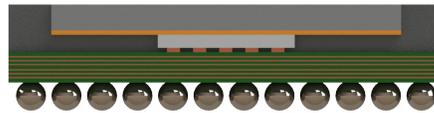


Si Integrated Heat Spreaders for fcCSP Packages

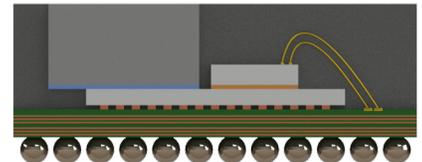
Siはヒートスプレッダの素材としてCuの有効な代替品となります

- ▶ 安定した高い熱伝導率とプロセスの容易さから、Siはヒートスプレッダの素材としてCuの効果的な代替品となっています。
- ▶ Si Integrated Heat Spreader (IHS) は上面をヒートシンクとして露出させた状態でモールド内に埋め込むことが可能です。

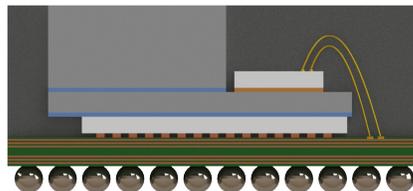
Si HISの使用例：



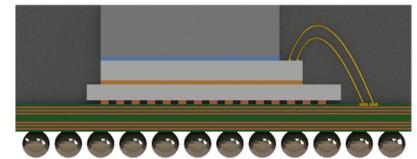
シングルチップfcCSPに埋め込み上面を露出したSi IHS



サイドバイサイド ハイブリッド構造に埋め込み上面を露出したSi IHS



ハイブリッド構造のデュアルSi IHS



スタックハイブリッド構造に埋め込み上面を露出したSi IHS

凡例

	Si Integrated Heat Spreader (IHS)		フリップチップバンプ
	Thermal Interface Material (TIM)		ワイヤボンドフィンガー
	アクティブSi (フリップチップ/ワイヤーボンド)		基板
	ダイアタッチ材		はんだボール
			ワイヤボンド

Si Integrated Heat Spreader Considerations

Amkorのパッケージング技術により、Si上面をヒートシンクとして露出させた状態でモールド内に埋め込むことが可能です。

詳細についてはamkor.comにアクセス、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。



本文中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。© 2019 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. TS115B 04/19